

SKC, R&H와 CMP패드 특허분쟁

R&H, 특허침해금지 가처분 신청 ... SKC는 특허등록 무효심판 청구

SKC가 미국 화학기업 Rohm & Haas와 특허침해 여부를 놓고 마찰을 빚고 있다.

SKC는 2004년 개발한 화학적 기계연마(CMP) 패드 기술과 관련해 R&H가 2005년 1월 국내 법원에 특허침해금지 가처분신청을 제기한데 대해 3월 R&H를 상대로 특허심판원에 특허등록 무효심판을 청구했다고 4월6일 발표했다.

SKC 관계자는 “우리가 생산하는 CMP 패드는 독자 개발한 기술이나 R&H는 자신들의 특허를 침해한 것이라고 주장하고 있다”고 밝혔다.

CMP 패드는 반도체 웨이퍼의 표면을 평탄하게 만드는 연마제로 현재 국내시장은 400억원, 세계시장은 2500억원 정도로 추산되며 2007년에는 6000억원으로 늘어날 전망이다.

<화학저널 2005/04/08>